

关于半导体芯片进行高低温测试的一些关键



关于半导体芯片进行高低温测试的一些关键

半导体芯片进行高低温测试，需要用到勤卓品牌高低温试验箱，本设备具有简单便利的操作性能和可靠的设备性能可以测试半导体陶磁及高分子材料之物理性变化。

半导体芯片高低温测试需要特别注意，在使用的过程中不能轻易打开半导体芯片高低温试验箱，主要原因如下：

半导体芯片高低温测试是模拟环境的试验箱，在使用时，试验箱内可能会有各种极端的环境，例如较低温、高温高压、高温高湿等特殊条件。

如果试验箱中正在进行-70 的较低温测试，这个时候打开试验箱门，先寒冷的气流会溢出试验箱，如果我们的手指没有做任何防护触摸到试验箱壁样品上，会瞬间冻伤，冻伤部位的肌肉组织甚至会坏死。另外在较低温的情况下打开试验箱门可能会造成蒸发器结霜，会影响降温速度，甚至有可能造成压缩机损坏等问题。

如果试验箱中正在进行高温150 的测试时打开试验箱门，高温气体会瞬间冲出试验箱，如果没有做好相关防护，很有可能会烫伤我们的面部，如果试验箱旁有燃点低的可燃物，甚至可能会引起起火。

如果是其他环境试验设备时，比如恒温恒湿试验箱在进行高温高湿试验箱时，仪器内的压力和蒸汽会非常大，如果在此时打开试验箱门，也会有高温高湿的蒸汽冲出试验箱，也较有可能对操作人员造成严重的烫伤。

所以，在半导体芯片高低温测试运行中途，若没有非常必要打开试验箱门，请勿打开试验箱门，如果须要使用中途打开试验箱门，那么请一定做好相关的防护措施，用正确的方法打开试验箱门。

原文地址：<http://www.china-nengyuan.com/news/203459.html>